

积层陶瓷电容 规格书

产品系列

NM1206N103J631CEGN

产品名称

常规品-中电压

1206,C0G,10nF,±5%,630V

2022.11.01
(Ver.01)

1. 产品简介

汇聚中压设计产品使用无铅/锡元素材料制作.此系列特性产品可应用于较高电压的应用环境.藉由精确的介电材料配制及适当的导电浆料搭配,以及自动化制程的稳定生产和严谨的质量把关,以精确控制了介电设计厚度、电极完整性还有外端电子端极连接的良好特性,实现了最佳可靠度的产品性能.

2. 特点

- 2.1.电压使用选择范围广.
- 2.2.端子电极无铅化.
- 2.3.符合危害性物质限制指示标准(RoHS)。
- 2.4.高可靠性和安定性。

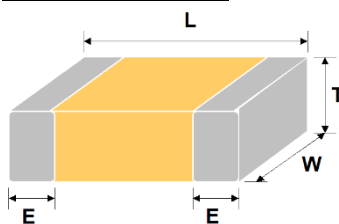
3. 用途

- 3.1.一般数位电路应用.
- 3.2.直流对直流转换应用.
- 3.3.高压耦合与直流退耦应用.
- 3.4.背光逆变器应用.
- 3.5.高频功率转换器电压尖脉冲缓冲应用.

4. 型号标示:

NM	1206	N	103	J	631	C	E	G	N	序号	标示	说明
系列	外型尺寸	介电质	电容量	公差	额定电压	端接类型	包装	厚度	管理码	1	NM	常规品-中电压
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	1206	LxW=3.20mm x 1.60mm
										3	N	C0G
										4	103	10nF
										5	J	±5%
										6	631	630V
										7	C	Cu+ Ni+Sn
										8	E	7" Reel 卷装-塑料带
										9	G	1.60 ± 0.20 mm
										10	N	常规无特殊要求

5. 外型尺寸



英制尺寸	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	端电极宽 (E)
1206	3.20 ±0.20	1.60 ±0.20	1.60 ±0.20	0.50 ±0.30

Unit:mm

6. 一般电气规格

介电质	C0G
尺寸	1206
直流额定电压	630V
电容量范围	10nF
电容量公差值	±5%
损耗角正切 (Tan δ) & 质量因子 (Q)	Q≥1000
检测条件	1.0±0.2Vrms, 1.0±0.1KHz 25°C 常温环境.
绝缘组抗值 (IR)	≥10 GΩ
操作环境温度	- 55°C to + 125 °C
温度公差系数	±30ppm
端电极材料	铜 / 镍 / 锡

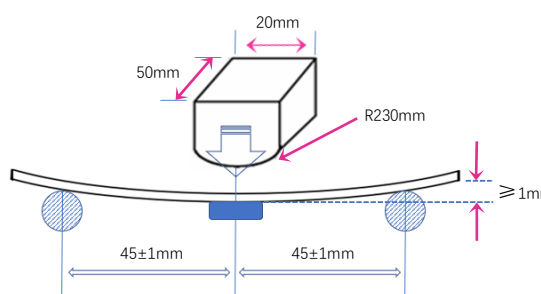
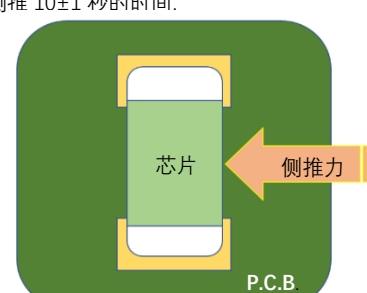
7.可靠度检测条件与质量要求

项次	项目	检测条件	质量要求												
1	外观	---	*无目视明显可见之缺陷. *外型尺寸符合规格标准.												
2	电容量	测量温度:25℃ 常温环境. 测量电压:1.0±0.2Vrms, 测量频率:1.0±0.1KHz	*不可超出规范定义之范围												
3	Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	测量温度:25℃ 常温环境. 测量电压:1.0±0.2Vrms, 测量频率:1.0±0.1KHz	<table><tr><th>介电类别</th><th>额定电压</th><th>Q/D.F.</th><th>备注</th></tr><tr><td>1 类产品:</td><td>630V</td><td>Q≥1000</td><td></td></tr></table>	介电类别	额定电压	Q/D.F.	备注	1 类产品:	630V	Q≥1000					
介电类别	额定电压	Q/D.F.	备注												
1 类产品:	630V	Q≥1000													
4	温度特性	<table><tr><th colspan="2">无外加电压</th></tr><tr><th>介电特性</th><th>操作温度</th></tr><tr><td>C0G</td><td>-55~125℃</td></tr></table>	无外加电压		介电特性	操作温度	C0G	-55~125℃	<table><tr><th>介电特性</th><th>电容量变异率</th></tr><tr><td>C0G</td><td>介于±30ppm/℃ 之间</td></tr></table>	介电特性	电容量变异率	C0G	介于±30ppm/℃ 之间		
无外加电压															
介电特性	操作温度														
C0G	-55~125℃														
介电特性	电容量变异率														
C0G	介于±30ppm/℃ 之间														
5	耐电压	<table><tr><th>额定电压 (V)</th><th>量测条件</th></tr><tr><td>630</td><td>1.5 倍额定电压</td></tr></table> *测试电压升压速率 100v/sec *持压时间: 1 to 5 sec. *充放电电流 ≤50mA.	额定电压 (V)	量测条件	630	1.5 倍额定电压	*无击穿或是闪火现象								
额定电压 (V)	量测条件														
630	1.5 倍额定电压														
6	绝缘阻抗 (IR)	<table><tr><th>额定电压 (V)</th><th>外加电压</th><th>充电时间</th></tr><tr><td>630</td><td>500V</td><td>60 sec</td></tr></table>	额定电压 (V)	外加电压	充电时间	630	500V	60 sec	<table><tr><th>介电类别</th><th>要求</th></tr><tr><td>1 类</td><td>≥10 GΩ</td></tr></table>	介电类别	要求	1 类	≥10 GΩ		
额定电压 (V)	外加电压	充电时间													
630	500V	60 sec													
介电类别	要求														
1 类	≥10 GΩ														
7	可焊性	* 焊锡温度: 245±5℃ * 预热@100℃ / 30sec * 浸渍时间: 2±0.5 sec.	*焊锡层不小于 95%覆盖面积于端子电极上												
8	焊接耐热性	*预热处理: 焊锡浸渍前必须先进行 120 ~ 150℃ / 1 分钟 之预热动作. *焊锡温度: 260±5℃ *浸渍时间: 10±1.0 sec *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; 时间:24±2 小时.	<table><tr><td>介电类别</td><td>1 类</td></tr><tr><td>端子外观</td><td>无目视明显可见之缺陷</td></tr><tr><td>电容量变化</td><td>介于±2%</td></tr><tr><td>Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td><td>符合初始标准</td></tr><tr><td>绝缘阻抗 I.R</td><td>符合初始标准</td></tr><tr><td>耐电压</td><td>符合初始标准</td></tr></table>	介电类别	1 类	端子外观	无目视明显可见之缺陷	电容量变化	介于±2%	Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	符合初始标准	绝缘阻抗 I.R	符合初始标准	耐电压	符合初始标准
介电类别	1 类														
端子外观	无目视明显可见之缺陷														
电容量变化	介于±2%														
Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	符合初始标准														
绝缘阻抗 I.R	符合初始标准														
耐电压	符合初始标准														

7.可靠度检测条件与质量要求

项次	项目	测试条件	质量要求																											
9	温度循环	*需将晶片透过 reflow 焊接于 p.c.板上. *参照下表原则执行 5 回次循环测试. <table><tr><th>步骤</th><th>温度. (°C)</th><th>时间(分钟)</th></tr><tr><td>1</td><td>最低工作温度.+0/-3</td><td>30±3</td></tr><tr><td>2</td><td>常温.</td><td>2~3</td></tr><tr><td>3</td><td>最高工作温度.+3/-0</td><td>30±3</td></tr><tr><td>4</td><td>常温.</td><td>2~3</td></tr></table> *后处理：作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; 时间:24±2 小时.	步骤	温度. (°C)	时间(分钟)	1	最低工作温度.+0/-3	30±3	2	常温.	2~3	3	最高工作温度.+3/-0	30±3	4	常温.	2~3	<table><tr><td>介电类别</td><td>1 类</td></tr><tr><td>端子外观</td><td>无目视明显可见之缺陷</td></tr><tr><td>电容量变化</td><td>介于±2.0%</td></tr><tr><td>Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td><td>Q≥500</td></tr><tr><td>绝缘阻抗 I.R</td><td>符合初始标准</td></tr><tr><td>耐电压</td><td>符合初始标准</td></tr></table>	介电类别	1 类	端子外观	无目视明显可见之缺陷	电容量变化	介于±2.0%	Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥500	绝缘阻抗 I.R	符合初始标准	耐电压	符合初始标准
			步骤	温度. (°C)	时间(分钟)																									
			1	最低工作温度.+0/-3	30±3																									
			2	常温.	2~3																									
			3	最高工作温度.+3/-0	30±3																									
			4	常温.	2~3																									
			介电类别	1 类																										
端子外观	无目视明显可见之缺陷																													
电容量变化	介于±2.0%																													
Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥500																													
绝缘阻抗 I.R	符合初始标准																													
耐电压	符合初始标准																													
10	耐湿性	*测试温度.: 40±2°C *环境湿度: 90~95% RH *测试时间: 500+24/-0hrs. *后处理：作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; 时间:24±2 小时.	<table><tr><td>介电类别</td><td>1 类</td></tr><tr><td>端子外观</td><td>无目视明显可见之缺陷</td></tr><tr><td>电容量变化</td><td>介于±2.0%</td></tr><tr><td>Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td><td>Q≥350</td></tr><tr><td>绝缘阻抗 I.R</td><td>≥1GΩ</td></tr></table>	介电类别	1 类	端子外观	无目视明显可见之缺陷	电容量变化	介于±2.0%	Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥350	绝缘阻抗 I.R	≥1GΩ																	
			介电类别	1 类																										
			端子外观	无目视明显可见之缺陷																										
			电容量变化	介于±2.0%																										
			Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥350																										
			绝缘阻抗 I.R	≥1GΩ																										
11	耐湿负载	*测试温度.: 40±2°C *环境湿度: 90~95% RH *测试时间: 500+12/-0hrs. *外加电压: 500V. *充放电电流限制: ≤50mA *后处理：作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; 时间:24±2 小时.	<table><tr><td>介电类别</td><td>1 类</td></tr><tr><td>端子外观</td><td>无目视明显可见之缺陷</td></tr><tr><td>电容量变化</td><td>介于±2.0%</td></tr><tr><td>Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td><td>Q≥350</td></tr><tr><td>绝缘阻抗 I.R</td><td>≥1GΩ</td></tr></table>	介电类别	1 类	端子外观	无目视明显可见之缺陷	电容量变化	介于±2.0%	Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥350	绝缘阻抗 I.R	≥1GΩ																	
			介电类别	1 类																										
			端子外观	无目视明显可见之缺陷																										
			电容量变化	介于±2.0%																										
			Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥350																										
绝缘阻抗 I.R	≥1GΩ																													

7.可靠度检测条件与质量要求

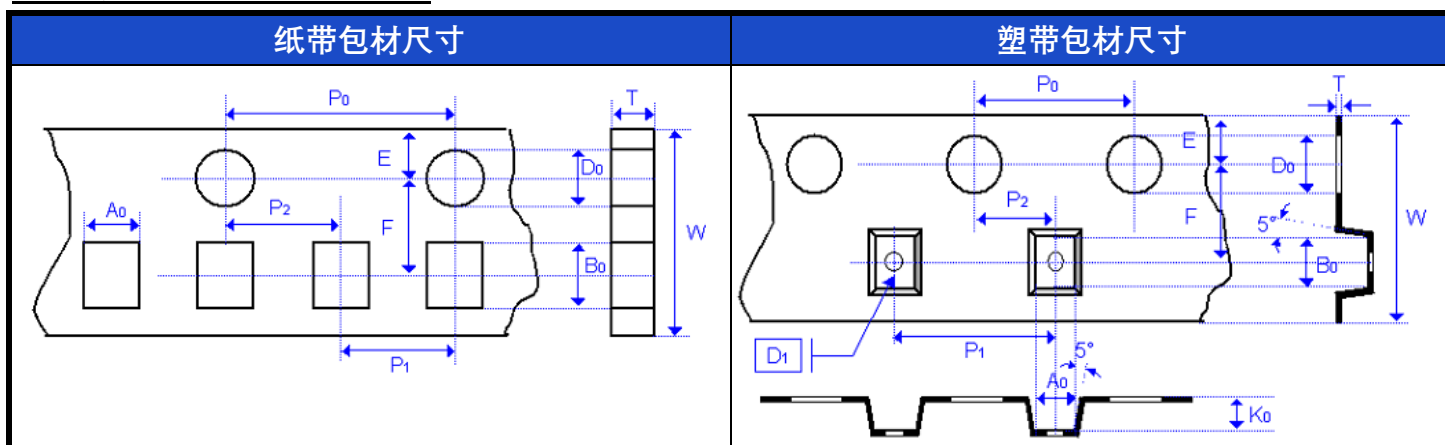
项次	项目	测试条件	质量要求		
12	高温可靠度	*需将晶片透过 reflow 焊接于 p.c.板上. *测试温度 : 125±3°C *测试电压 : 1.2 倍额定电压 *测试时程: 1000+12/-0 hrs *充放电限制: .≤50mA *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; 时间:24±2 小时.	介电类别	1 类	
			端子外观	无目视明显可见之缺陷	
			电容量变化	介于±2.0%	
			Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	Q≥350	
			I.R	≥1GΩ	
13	耐基板弯曲	*焊接安装于印刷电路板上之芯片元件必须能承受至少基板弯曲: ≥1mm 程度 *使用:圆径 230mm/宽度 20mm/长度 50mm 之压杆测试作业时 必须推压于印刷电路板的中心点位置 (同芯片元件中心点) ,推压 速度为 5mm/秒,持续推压直到需求弯曲程度或是失效为止.	介电类别	1 类	(电容量之差异变化量之参考点为板弯零点 (未弯曲) 数值.)
			端子外观	无目视明显可见之缺陷	
			电容量变化	介于±2.0%	
					
14	端子电极 附着力	* 将芯片元焊接件安装于基板上. 并施予一个 10N 的垂直力量,由 侧边方向加诸于基板上芯片两端电极间之中心等距离处, 并维 持加压侧推 10±1 秒的时间.	 *芯片元件无产生目视可见缺损缺陷,或是由印刷线路上脱落.		
15	震动测试	* 振动频率 : 10~55 Hz/每分 * 振幅(amplitude) : 1.5mm * 检验时间 : 6 小时(X/Y/Z 每三方向 各 2 小时)	*芯片元件无产生目视可见缺损缺陷,或是由印刷线路上脱落. *电容变异 & Q/DF : 符合初始规格		

8.包装尺寸规格及数量

尺寸	厚度 (mm)	纸带		塑带	
		7" 卷轮	13" 卷轮	7" 卷轮	13"卷轮
0603	0.80±0.07	4K	15K	-	-
	0.80+0.15/-0.10	4K	15K		
0805	0.60±0.10	4K	15K	-	-
	0.80±0.10	4K	15K	-	-
	1.25±0.10	-	-	3K	10K
	1.25±0.20	-	-	3K	-
1206	0.80±0.10	4K	15K	-	-
	0.95±0.10	-	-	3K	10K
	1.25±0.10	-	-	3K	10K
	1.60±0.20	-	-	2K	-
1210	0.95±0.10	-	-	3K	10K
	1.25±0.10	-	-	3K	10K
	1.60±0.20	-	-	2K	-
	2.50±0.30	-	-	1K	-
1808	1.25±0.10	-	-	2K	-
	1.60±0.20	-	-	2K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
1812	1.25±0.10	-	-	1K	-
	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
1825	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
	2.80±0.30	-	-	0.5K	-
2211	2.00±0.20	-	-	1K	
	2.50±0.30	-	-	0.5K	
2220	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	
	2.80±0.30	-	-	0.5K	-
2225	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	
	2.80±0.30	-	-	0.5K	-

包装数量单位: pcs

8. 包装尺寸规格及数量



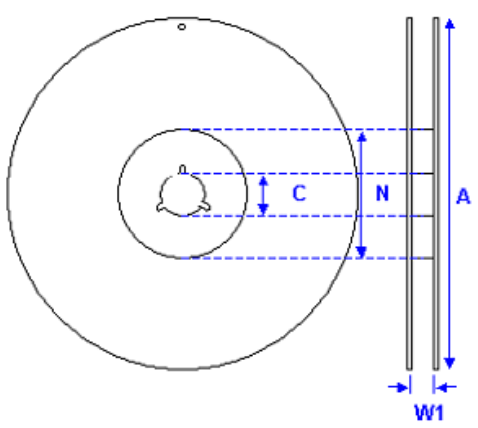
外型尺寸	0603		0805		1206		
芯片厚度	0.80±0.07	0.80+0.15/-0.10	0.80±0.10	1.25±0.10 1.25±0.20	0.80±0.10	0.95±0.10 1.25±0.10	1.60±0.20 1.60+0.3/-0.1
A ₀	1.00+0.05/-0.10	1.02+0.05/-0.10	1.50±0.10	<1.65	2.00±0.10	<2.00	<2.00
B ₀	1.80±0.10	1.80±0.10	2.30±0.10	<2.40	3.50±0.10	<3.60	<3.70
T	0.95±0.05	0.97±0.05	0.95±0.05	0.23±0.05	0.95±0.05	0.23±0.05	0.23±0.05
K ₀	-	-	-	<2.50	-	<2.50	<2.50
W	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10
P ₀	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
10xP ₀	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20
P ₁	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
P ₂	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05
D ₀	1.55±0.05	1.55±0.05	1.55±0.05	1.50±0.10/-0	1.55±0.05	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0
D ₁	-	-	-	1.00±0.10	-	1.00±0.10	1.00±0.10
E	1.75±0.05	1.75±0.05	1.75±0.05	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10
F	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05
尺寸单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

外型尺寸	1210		1808		1812	
芯片厚度	0.95±0.10 1.25±0.10 1.60±0.20	2.50±0.30	1.25±0.10 1.60±0.20	2.00±0.20	1.25±0.10 1.60±0.20 2.00±0.20	2.50±0.30
A ₀	<3.05	<3.10	<2.50	<2.50	<3.90	<3.90
B ₀	<3.80	<4.00	<5.30	<5.30	<5.30	<5.30
T	0.23±0.05	0.23±0.05	0.25±0.05	0.25±0.05	0.25±0.05	0.25±0.05
K ₀	<2.50	<3.50	<2.50	<2.50	<2.50	<3.00
W	8.00±0.10	8.00±0.10	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20
P ₀	4.00±0.100	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
10xP ₀	40.00±0.20	40.0±0.10	40.0±0.20	40.0±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20
P ₁	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10
P ₂	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05
D ₀	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0
D ₁	1.00±0.10	1.00±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50+/-0.10
E	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75+/-0.1
F	3.50±0.05	3.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50+/-0.05
尺寸单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm

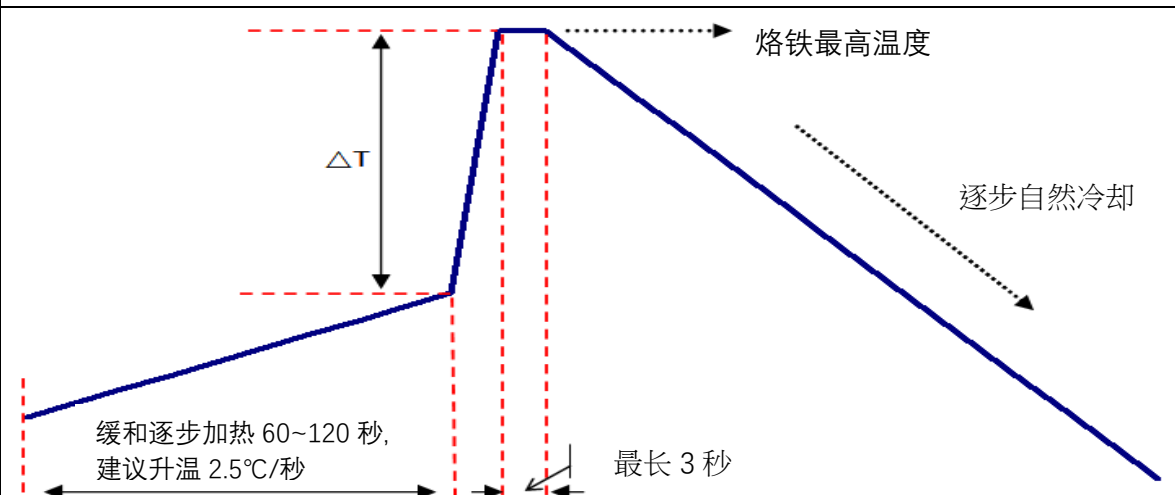
8. 包装尺寸规格及数量

外型尺寸	1825		2211		2220		2225	
芯片厚度	1.60±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20	2.50±0.30	2.00±0.20	2.50±0.20	2.00±0.20 1.60±0.20	2.50±0.30	1.60±0.20 2.00±0.20	2.50±0.30
A ₀	<6.80	<6.80	< 3.30	< 3.30	<5.80	<5.80	<6.80	<6.80
B ₀	<5.30	<5.30	< 6.50	< 6.50	<6.50	<6.50	<6.50	<6.50
T	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10
K ₀	<2.50	<3.10	<2.50	< 3.10	<2.50	<3.10	<2.50	<3.10
W	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20
P ₀	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
10xP ₀	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20
P ₁	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10
P ₂	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05
D ₀	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0
D ₁	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10
E	1.75±0.1	1.75±0.10	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10
F	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05
尺寸单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

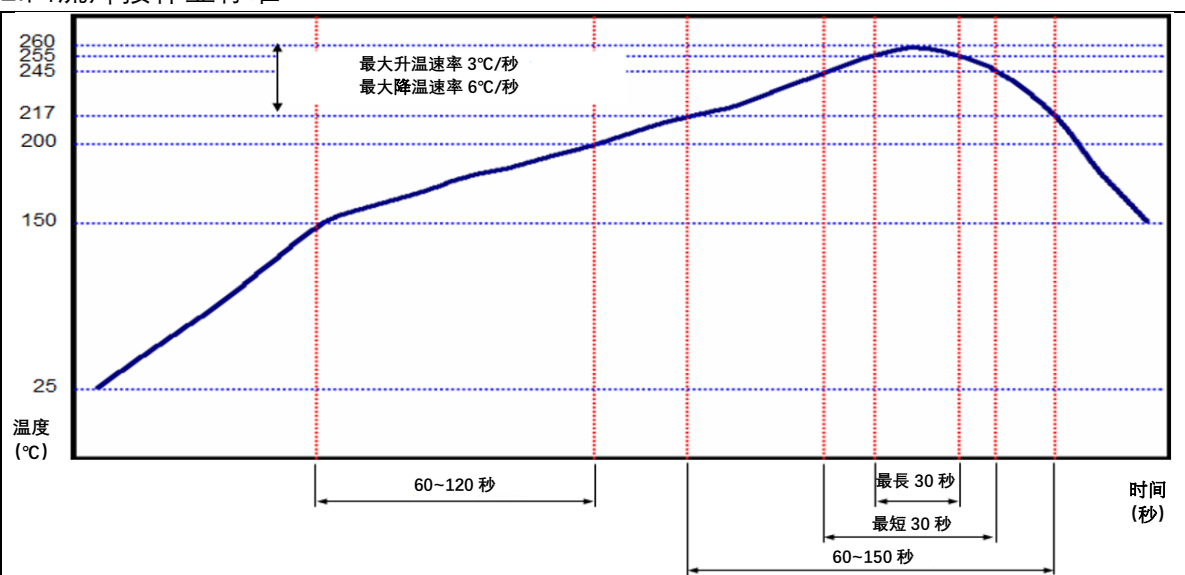
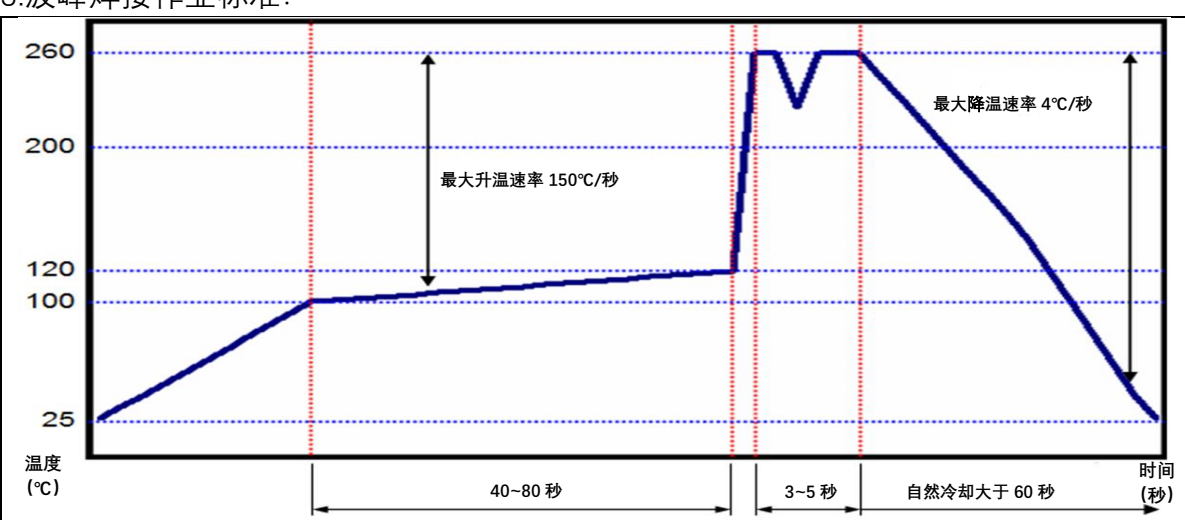
卷轮尺寸

外型尺寸	0603, 0805, 1206, 1210			1808,1812, 1825, 2211,2220,2225	
卷轮尺寸	7"	7"	13"	7"	
C	13.0 +0.5/-0.2	13.0 +0.5/-0.2	13.0 +0.5/-0.2	13.0 +0.5/-0.2	
W ₁	8.4 +1.5/-0	8.4 +1.5/-0	8.4 +1.5/-0	12.4 +2.0/-0	
A	178.0 ±0.10	178.0 ±0.10	330.0 ±1.0	178.0 ±0.10	
N	60.0 +1.0/-0	80.0 ±1.0	100 ±1.0	60.0 +1.0/-0	

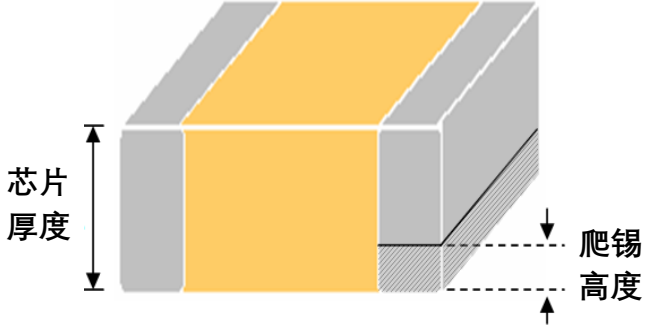
9. 产品使用说明

项次	项目	说明												
1	存储	1.为了避免端子电极可焊性的损害以及老化影响,建议依循以下条件进行储存置放: 室内环境: 温度: 5~40℃ / 湿度: 20%~70%RH. 并且应避免与含有硫酸, 氨, 硫化氢或氯无有害气体等酸硷性化学品同时存放. 2.无需用芯片元件时,不可将包装好之产品拆装.如果已经拆装并残留有未使用之余料者,应尽快在以真空方式进行密封予以保存. 3.卷装包装或散装包装产品皆不可存放具有直接日照曝晒的区域环境之中,这可能会造成包材老化或是胶带附着性能恶化,甚至于产品端子氧化焊性失效可能. 4.产品建议必须自交货后 12 个月内使用完毕,使用前异必须检测可焊性之状况.												
2	使用处理	陶瓷芯片电容产品材料本质具:高密度/坚硬/易碎/受磨损之特性,故容易被机械作用所损坏而造成破损或是裂痕.因此元件必须格外小心使用,避免污染或是碰撞损伤. 建议使用真空吸取方式或是塑胶夹具取放元件为恰当.载带包装好之卷装产品,较适用于自动化生产作业制程作业.												
3	作业预热处理	为了降低及避免焊锡作业过程中的温度热冲击影响,控制预热温度条件的考量是必要的,预热区段的温度升温速度不可大过于 3℃为佳.												
4	焊锡作业	作业时应使用无活性松香助焊剂和弱活性松香助焊剂,切勿使用活性助焊剂. 为防止因焊料造成芯片和基板之间的应力影响而造成元件的损坏,作业中必须确实衡量与控制在每个焊点的焊料使用比率. 1.人工焊接作业标准: 人工焊接作业温度曲线 <table><thead><tr><th>芯片尺寸</th><th>预热温度</th><th>ΔT (温差)</th><th>烙铁最高温度</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤1206</td><td>≥150 ℃</td><td>≤150 ℃</td><td>≤350 ℃</td></tr><tr><td>1210~2225</td><td>≥150 ℃</td><td>≤130 ℃</td><td>≤280 ℃</td></tr></tbody></table> *烙铁末端直径需≤1.0mm,且加热功率不可大于 20 瓦. *芯片必须用烙铁末端于未接触元件的情况下以,适合的温度曲线条件进行预热. *欲上焊的锡高必须先附于烙铁末端再行上焊,且烙铁不可直接接触到芯片元件本体. *上焊后芯片元件必须在常温中自然冷却,切勿借助外力强制吹风冷却.	芯片尺寸	预热温度	ΔT (温差)	烙铁最高温度	≤1206	≥150 ℃	≤150 ℃	≤350 ℃	1210~2225	≥150 ℃	≤130 ℃	≤280 ℃
芯片尺寸	预热温度	ΔT (温差)	烙铁最高温度											
≤1206	≥150 ℃	≤150 ℃	≤350 ℃											
1210~2225	≥150 ℃	≤130 ℃	≤280 ℃											

9. 产品使用摘要

项次	项目	说明																																																
4	焊锡作业	2.回流焊接作业标准：  温度 (°C) 时间 (秒) 最大升温速率 3°C/秒 最大降温速率 6°C/秒 60~120 秒 最长 30 秒 最短 30 秒 60~150 秒 锡 / 银 / 铜 材质 适用焊锡膏 (无铅)																																																
		3.波峰焊接作业标准：  温度 (°C) 时间 (秒) 最大升温速率 150°C/秒 最大降温速率 4°C/秒 40~80 秒 3~5 秒 自然冷却大于 60 秒 锡 / 银 / 铜 材质 适用焊锡膏 (无铅)																																																
		4.焊接作业方式适用性：																																																
		<table><tr><th rowspan="2">芯片尺寸</th><th rowspan="2">介电类别.</th><th rowspan="2">电容量</th><th colspan="2">作业方式</th></tr><tr><th>波峰焊</th><th>回流焊</th></tr><tr><td>0402</td><td>1 类</td><td>全范围</td><td>X</td><td>○</td></tr><tr><td>0603~1206</td><td>1 类</td><td>全范围</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>≥1210</td><td>1 类</td><td>全范围</td><td>X</td><td>○</td></tr><tr><td>0402</td><td>2 类</td><td>全范围</td><td>X</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="2">0603</td><td>2 类</td><td>Cap. < 2.2μF</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2 类</td><td>Cap. ≥ 2.2μF</td><td>X</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="2">0805~1206</td><td>2 类</td><td>Cap. < 4.7μF</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2 类</td><td>Cap. ≥ 4.7μF</td><td>X</td><td>○</td></tr><tr><td>≥1210</td><td>2 类</td><td>全范围</td><td>X</td><td>○</td></tr></table>	芯片尺寸	介电类别.	电容量	作业方式		波峰焊	回流焊	0402	1 类	全范围	X	○	0603~1206	1 类	全范围	○	○	≥1210	1 类	全范围	X	○	0402	2 类	全范围	X	○	0603	2 类	Cap. < 2.2μF	○	○	2 类	Cap. ≥ 2.2μF	X	○	0805~1206	2 类	Cap. < 4.7μF	○	○	2 类	Cap. ≥ 4.7μF	X	○	≥1210	2 类	全范围
芯片尺寸	介电类别.	电容量				作业方式																																												
			波峰焊	回流焊																																														
0402	1 类	全范围	X	○																																														
0603~1206	1 类	全范围	○	○																																														
≥1210	1 类	全范围	X	○																																														
0402	2 类	全范围	X	○																																														
0603	2 类	Cap. < 2.2μF	○	○																																														
	2 类	Cap. ≥ 2.2μF	X	○																																														
0805~1206	2 类	Cap. < 4.7μF	○	○																																														
	2 类	Cap. ≥ 4.7μF	X	○																																														
≥1210	2 类	全范围	X	○																																														

9.产品使用摘要

项次	项目	说明
4	焊锡作业	5.爬锡高度:  建议最小爬锡高度至少 1/4 晶片高度,或是 500um 高度水准.取任一较小值以上判定. (参照自 IPC-610E)
		5.冷却处理: 焊锡后针对于芯片元件及基板材的冷却必须以自然降温的方式进行.建议在以常温中自然降温方式进行以缓和应力的影响. 6.清洁: 清洗系统的从芯片下除去焊剂残留物和污染物的能力是非常重要的.所有焊剂残余物必须使用合适的电子级清洗溶剂以清除表面之污染,以避免造成电极表面腐蚀.最佳方式是透过超声波装置进行清洗作业以达到最佳效果.得到良好的结果.最佳清洗作业方式是透过对生产需求较为适适切的系统来选择,如元件的组合,助焊剂与焊锡膏类别或是组装方法等.最终产品的清洁的状况还是取决于清洗系统的能力与搭配,对于应用而言是非常重要的.